

## 概述

CYPC357是一块小外形的贴片光电耦合器件，适合表面贴装生产。CYPC357是由一个砷化镓发光二极管和一个光电晶体管组成的光电耦合器，它的体积比DIP小，适用于高密度表面贴装应用，如可编程控制器等。

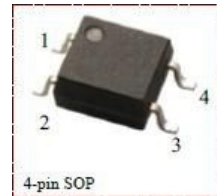
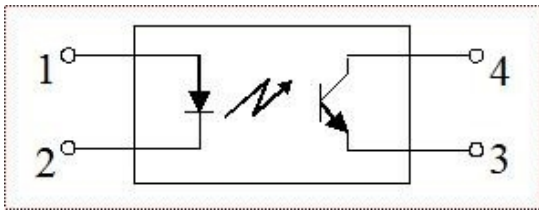
## 特性

- 电流转换比 (CTR)范围: 50~600% ( $I_F=5\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$ )
- 输入-输出隔离电压 ( $V_{iso}=3750\text{Vrms}$ )
- 集电极-发射极击穿电压  $BV_{CEO}\geq 80\text{V}$
- 工作温度:  $-55\sim 110^\circ\text{C}$
- UL 认证 (NO.:E497745)
- 符合 EU REACH 和 RoHS
- CQC 认证 (NO:CQC20001238559)

## Applications

- 开关电源，智能电表
- 工业控制，测量仪器
- 办公设备，比如复印机
- 家用电器，比如空调、风扇、热水器等

## 结构原理图和封装



## 极限参数 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数		符号	额定值	单位
输入	正向电流	$I_F$	50	mA
	正向脉冲电流	$I_{FP}$	1	A
	反向电压	$V_R$	6	V
	功耗	P	70	mW
	结温	$T_j$	125	$^\circ\text{C}$
输出	集电极功耗	$P_C$	150	mW
	集电极电流	$I_C$	50	mA
	集电极-发射极电压	$V_{CEO}$	80	V
	发射极-集电极电压	$V_{ECO}$	7	V
	结温	$T_j$	125	$^\circ\text{C}$
总功耗		$P_{tot}$	200	mW
隔离电压		$V_{iso}$	3750	Vrms
工作温度		$T_{opr}$	$-55\sim 110$	$^\circ\text{C}$
储存温度		$T_{stg}$	$-55\sim 125$	$^\circ\text{C}$
焊接温度		$T_{sol}$	260	$^\circ\text{C}$

**光电特性 (Ta=25°C)**

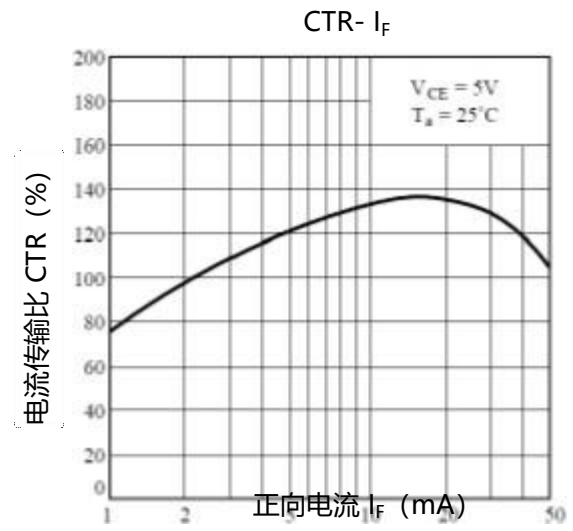
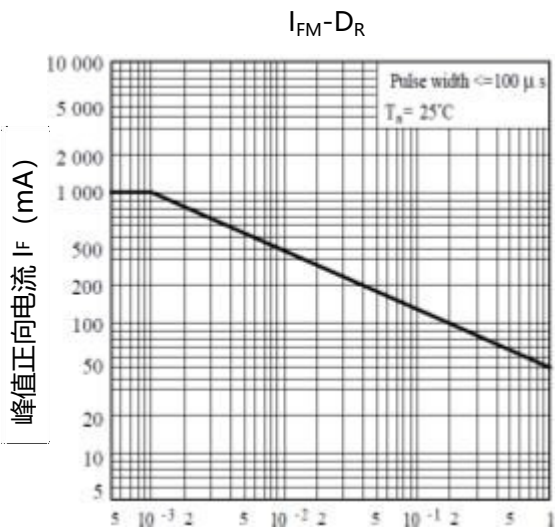
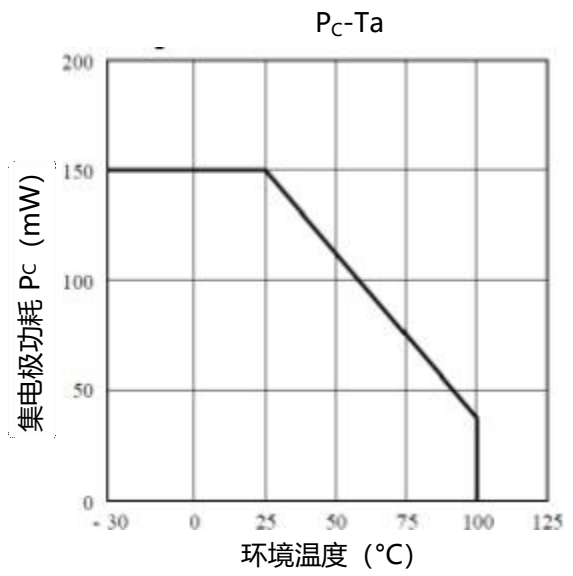
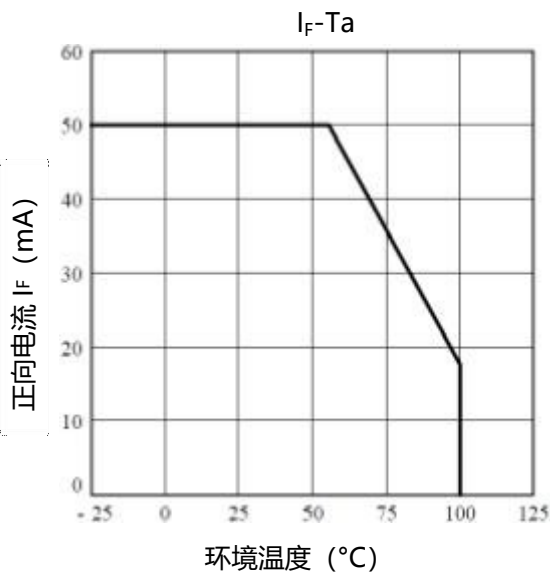
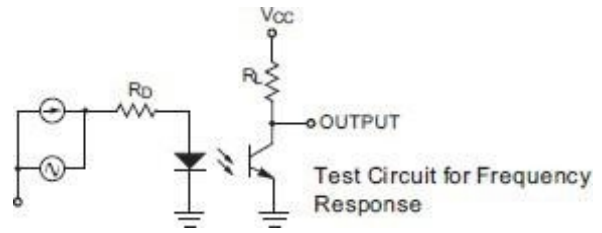
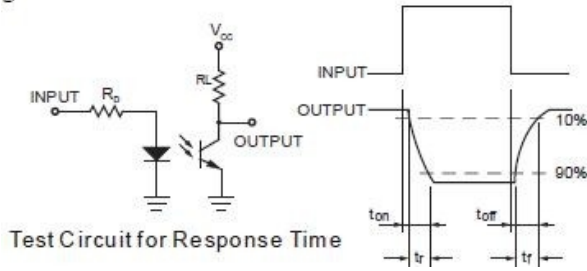
Parameter		Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
输入	正向电压	$V_F$	$I_F=20\text{mA}$		1.2	1.4	V
	反向电流	$I_R$	$V_R=5\text{V}$	-	-	10	$\mu\text{A}$
	终端电容	$C_t$	$V=0, f=1\text{kHz}$	-	30	250	pF
输出	集电极暗电流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=70\text{V}$	-	-	100	nA
	集电极-发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$I_C=0.1\text{mA}, I_F=0$	80	-	-	V
	发射极-集电极击穿电压	$BV_{ECO}$	$I_E=0.1\text{mA}, I_F=0$	7	-	-	V
传输特性	电流转换比	CTR	$I_F=5\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$	50	-	600	%
	集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_F=20\text{mA}, I_C=1\text{mA}$	-	0.1	0.2	V
	隔离电阻	$R_{ISO}$	DC1000V, 40~60%R.H.	$1 \times 10^{11}$	-	-	$\Omega$
	隔离电容	$C_f$	$V=0, f=1\text{MHz}$	-	0.6	1.0	pF
	集电极-发射极电容	$C_{CE}$	$V=0, f=1\text{MHz}$		10		pF
	截止频率	$F_c$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=2\text{mA},$ $R_L=100\Omega, -3\text{dB}$	-	80	-	kHz
开关时间	上升时间	$T_r$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=2\text{mA},$ $R_L=100\Omega$	-	4	18	$\mu\text{s}$
	下降时间	$T_f$		-	3	18	$\mu\text{s}$

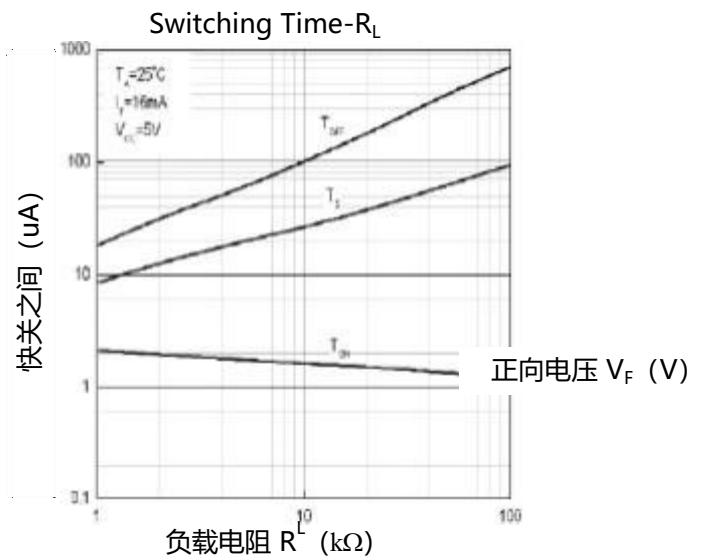
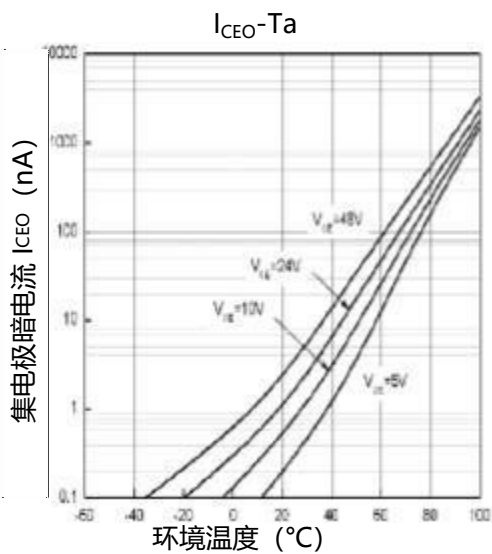
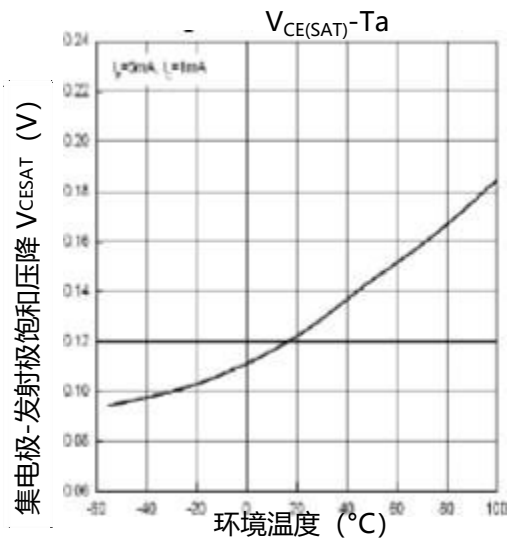
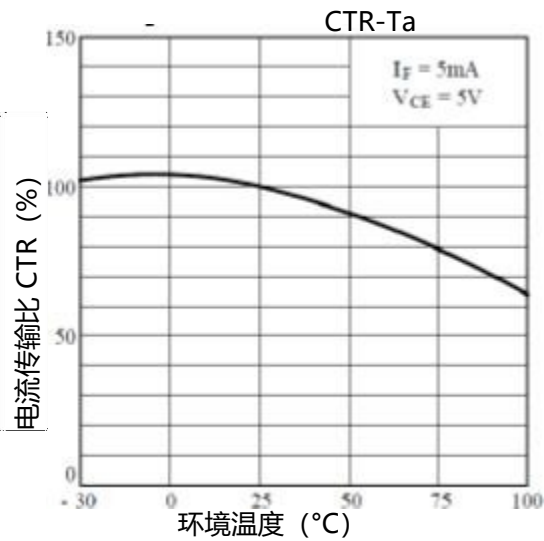
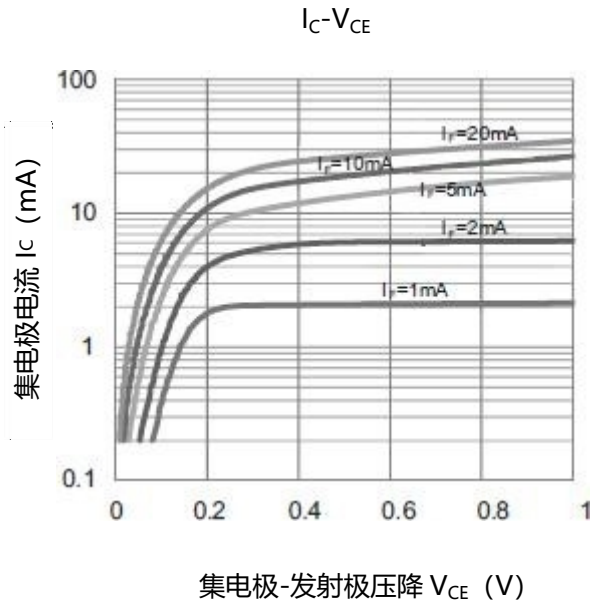
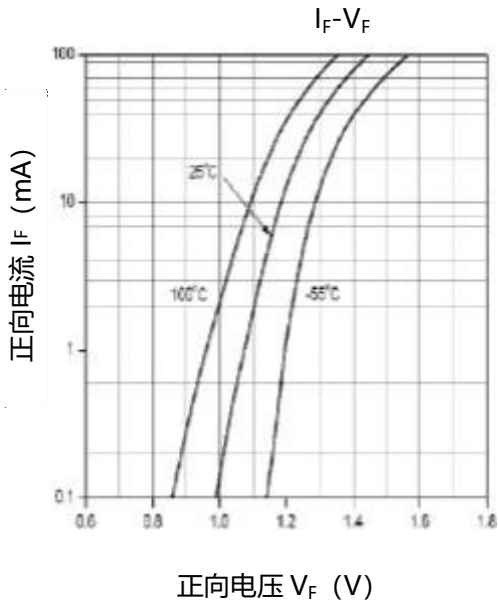
\*  $CTR=I_C/I_F \times 100\%$

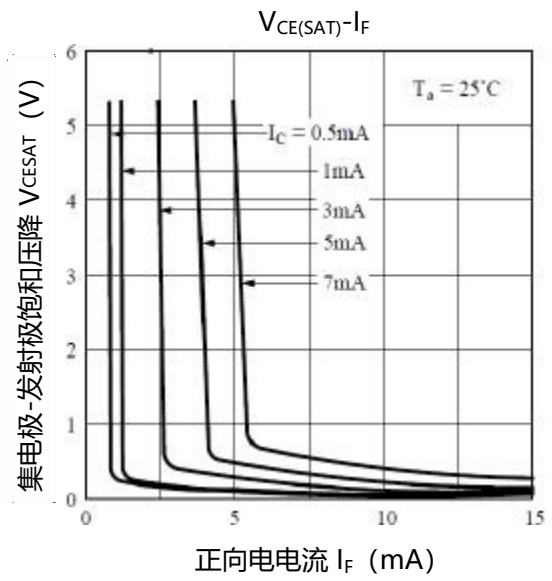
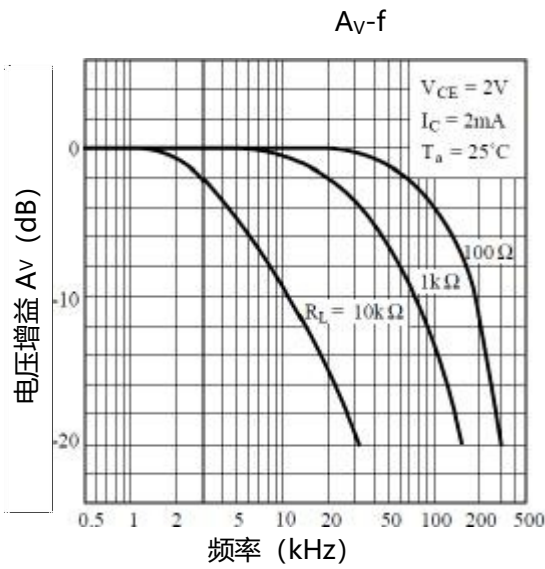
**CTR 分级表**

型号	分级标准	$I_C(\text{mA})$		对应 CTR (%)	
		$I_F = 5\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}, T_a = 25^\circ\text{C}$		$I_F = 5\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}, T_a = 25^\circ\text{C}$	
		Min	Max	Min	Max
CYPC357	Blank	2.5	30.0	50	600
	A	4.0	8.0	80	160
	B	6.5	13.0	130	260
	C	10.0	20.0	200	400
	D	15.0	30.0	300	600
	A or B	4.0	13.0	80	160
	B or C	6.5	20.0	130	400
	C or D	10.0	30.0	200	600
	A,B or C	4.0	20.0	80	400
	B,C or D	6.5	30.0	130	600
	A,B,C or D	4.0	30.0	80	600

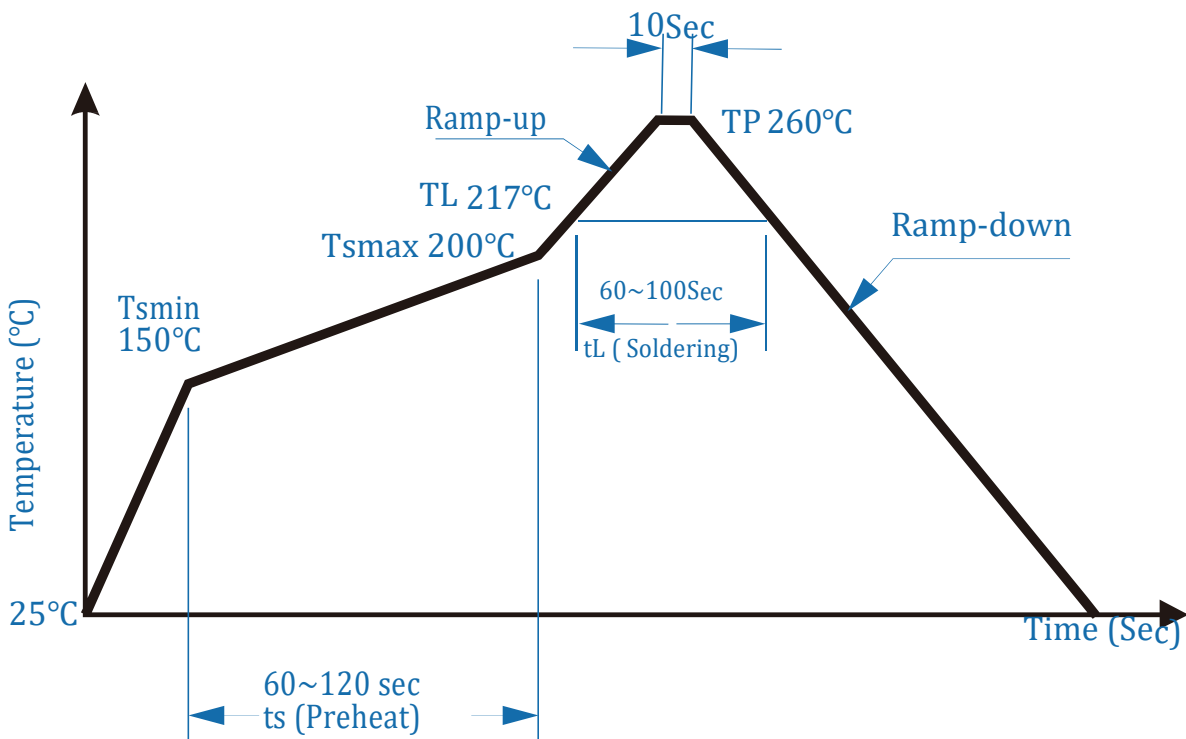
## 测试电路



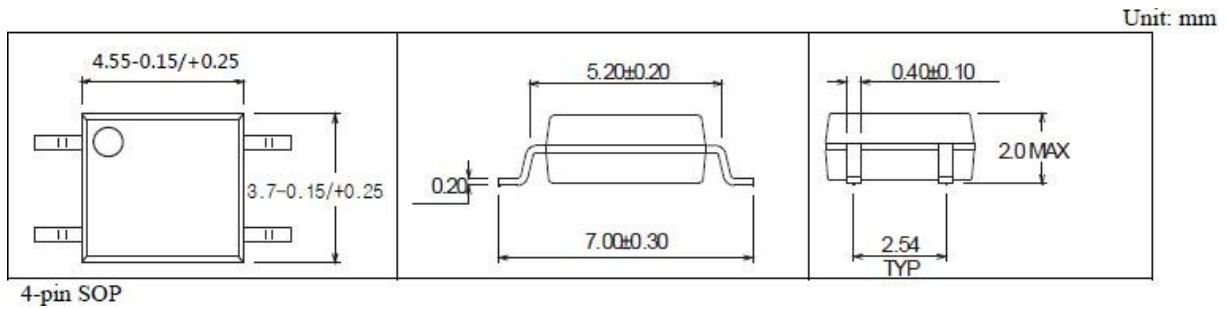




回流焊温度曲线图



## 外形尺寸



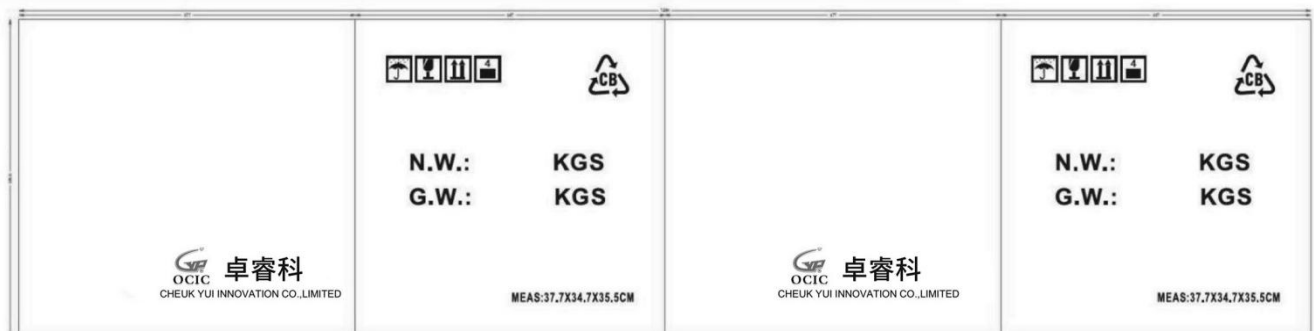
## 包装

封装形式	包装方式	盘数量	盒数量	箱数量	静电袋	盒规格	箱规格
SOP4	卷盘 ( $\phi 330$ mm)	3000PCS/盘	15000PCS/盒	60000PCS/箱	-	355*90*337mm	377*347*355mm

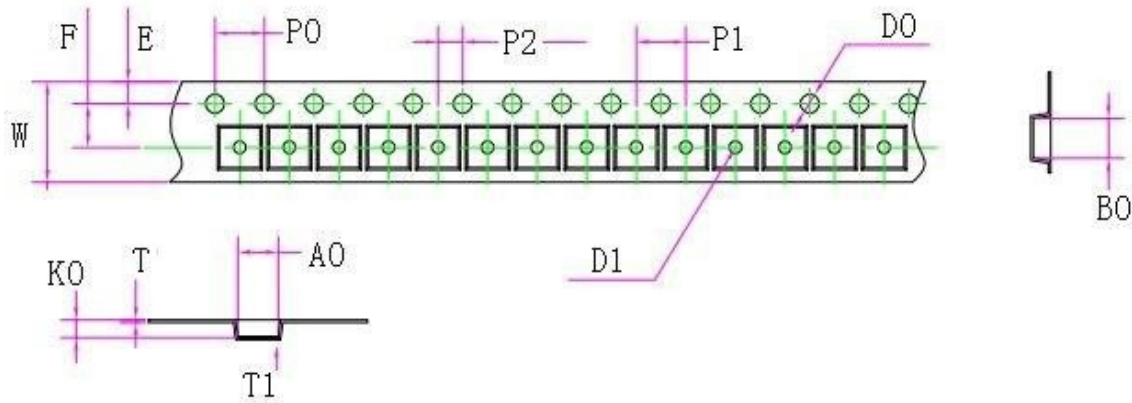
### 1) 内盒尺寸



### 2) 外箱尺寸



## 编带尺寸



W	E	F	D0	D1	P0
12.00±0.10	1.75±0.10	5.50±0.05	1.50+0.10/-0	1.50+0.10/-0	4.00±0.10
P1	P2	A0	B0	K0	T
8.00±0.10	2.00±0.10	3.90±0.10	7.38±0.10	2.50±0.10	0.2±0.05
T1	10*P0				
0.10min	40.00±0.20				

### 注意:

- 卓睿研发会持续不断改善质量、可靠性、功能或设计和提供更好的产品，保留在任何时候修改此规格的权利，恕不另行通知。
- 客户下单之前请确认手头的资料是最新版本，客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自己的要求。
- 请遵守产品规格书使用，卓睿研发不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。
- 如需要高可靠性且用于以上特定设备或装置的产品，如军事、核电控制、医疗、生命维持或救生等可能导致人身伤害或死亡的设备或装置，请联系我们销售代表以获取建议。
- 使用此产品时请采取措施防止静电损坏。
- 如对文件中表述的内容有疑问，欢迎联系我们。